

2020年3月期 第1四半期（2019年4月～6月） 東京エレクトロン 決算説明会

2019年7月26日

内容：

- 第1四半期 連結決算の概要 取締役 専務執行役員 布川 好一
- 事業環境および業績予想 代表取締役社長・CEO 河合 利樹

将来予想等に関する記述

- 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスクなど、様々な外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

- 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- 為替リスクについて

当社の主力製品である半導体製造装置およびFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。

FPD：フラットパネルディスプレイ

第1四半期 連結決算の概要

2019年7月26日

布川 好一

取締役 専務執行役員 ファイナンス本部担当



FY2020 Q1（2019年4月～6月）ハイライト

- Q1業績は上期計画に沿って順調に進捗
- 2019年5月以降 290万株の自己株式を取得済み
（2019年6月30日時点）
 - 取得価額の総額は432億円
 - 1,500億円の上限に対し、進捗率は29%

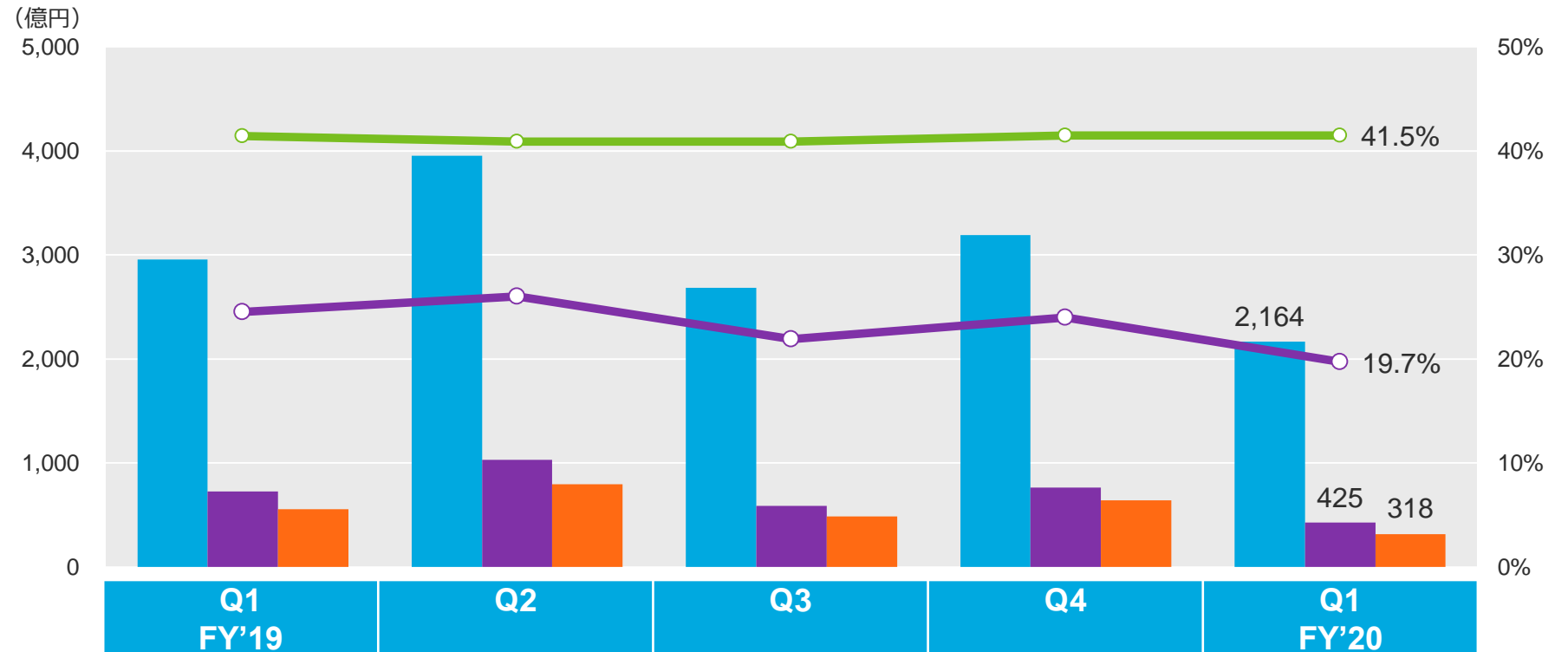
損益状況

(億円)

	FY2019				FY2020	対FY2019 Q4 増減率
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	
売上高	2,955	3,954	2,681	3,190	2,164	-32.2%
SPE	2,804	3,580	2,395	2,887	1,981	-31.4%
FPD	151	373	285	301	182	-39.6%
売上総利益	1,224	1,616	1,097	1,322	898	-32.1%
下段：売上総利益率	41.4%	40.9%	40.9%	41.5%	41.5%	+0.0pts
販管費	500	586	510	558	473	-15.3%
営業利益	724	1,030	587	764	425	-44.3%
下段：営業利益率	24.5%	26.0%	21.9%	24.0%	19.7%	-4.3pts
税金等調整前当期純利益	752	1,058	605	798	445	-44.2%
親会社株主に帰属する 当期純利益	557	795	488	641	318	-50.2%
研究開発費	261	312	265	300	256	-14.6%
設備投資額	96	132	118	149	76	-49.0%
減価償却費	50	56	62	73	60	-17.1%

1. 当社の主力製品である半導体製造装置およびFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。
一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

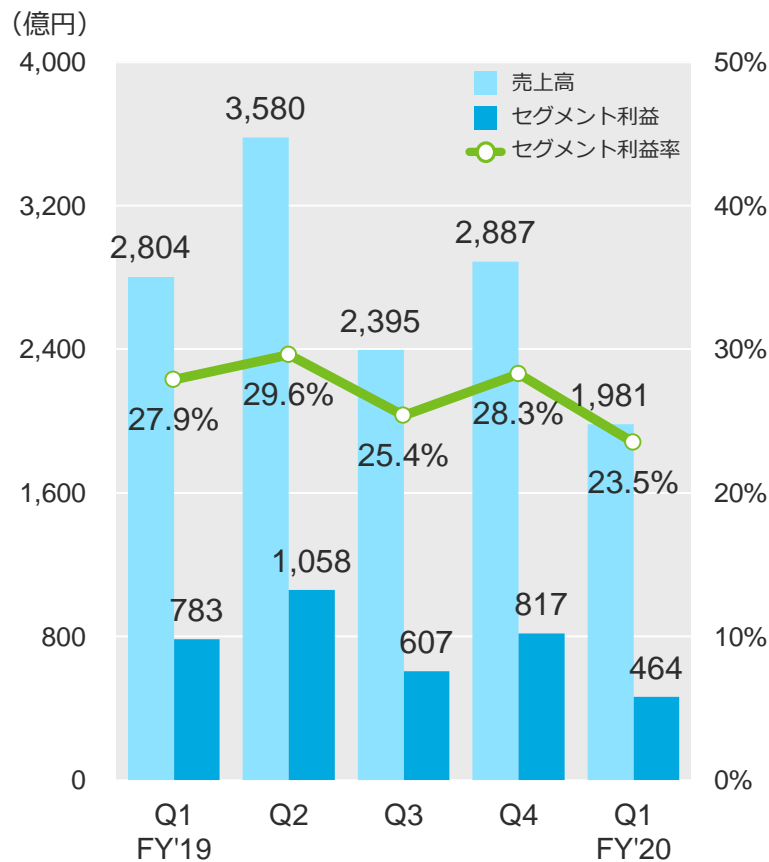
損益状況



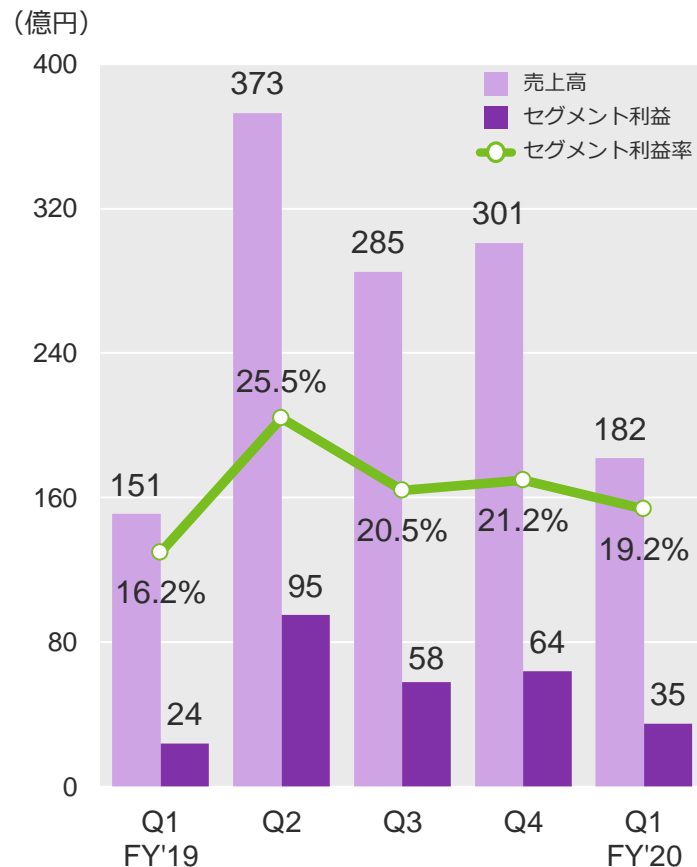
売上高	2,955	3,954	2,681	3,190	2,164
営業利益	724	1,030	587	764	425
親会社株主に帰属する 当期純利益	557	795	488	641	318
売上総利益率	41.4%	40.9%	40.9%	41.5%	41.5%
営業利益率	24.5%	26.0%	21.9%	24.0%	19.7%

セグメント情報

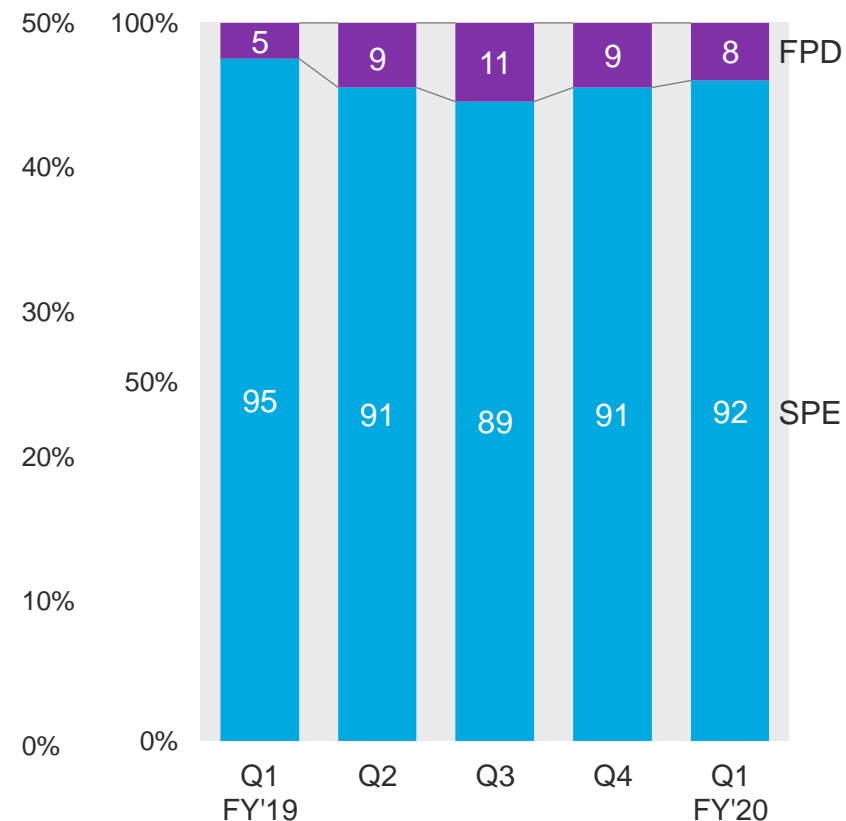
SPE (半導体製造装置)



FPD (フラットパネルディスプレイ製造装置)



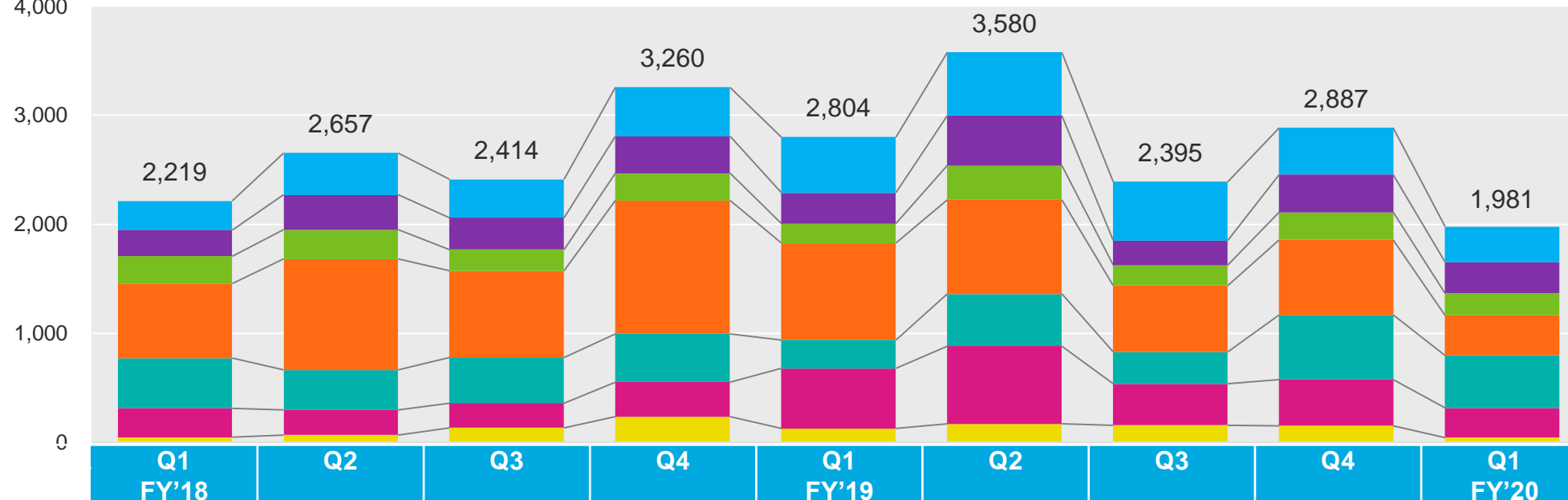
売上構成比率



1. セグメント利益は、税金等調整前当期純利益です。
2. 上記報告セグメントに配分していない基礎研究または要素研究等の研究開発費、およびその他の一般管理費等があります。
3. 売上構成比率は外部顧客に対する売上高で算出しています。

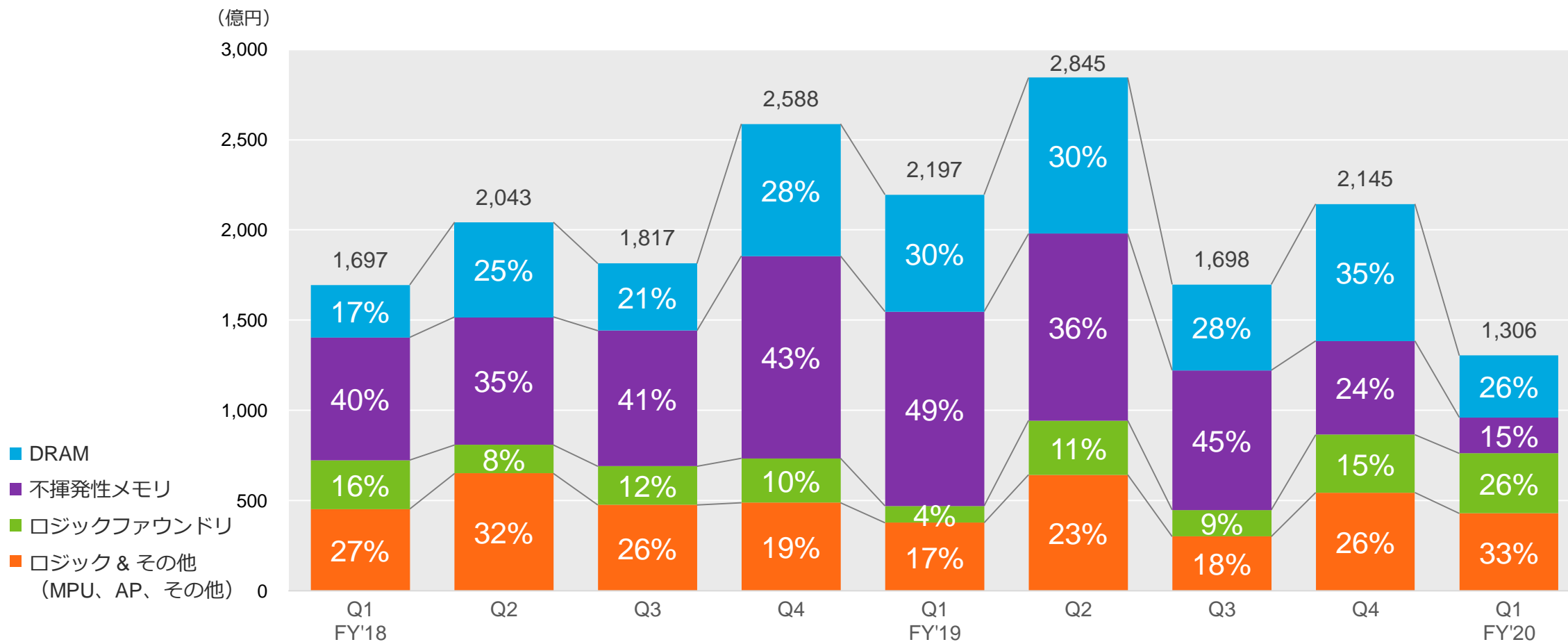
SPE部門 地域別売上高

(億円)
4,000



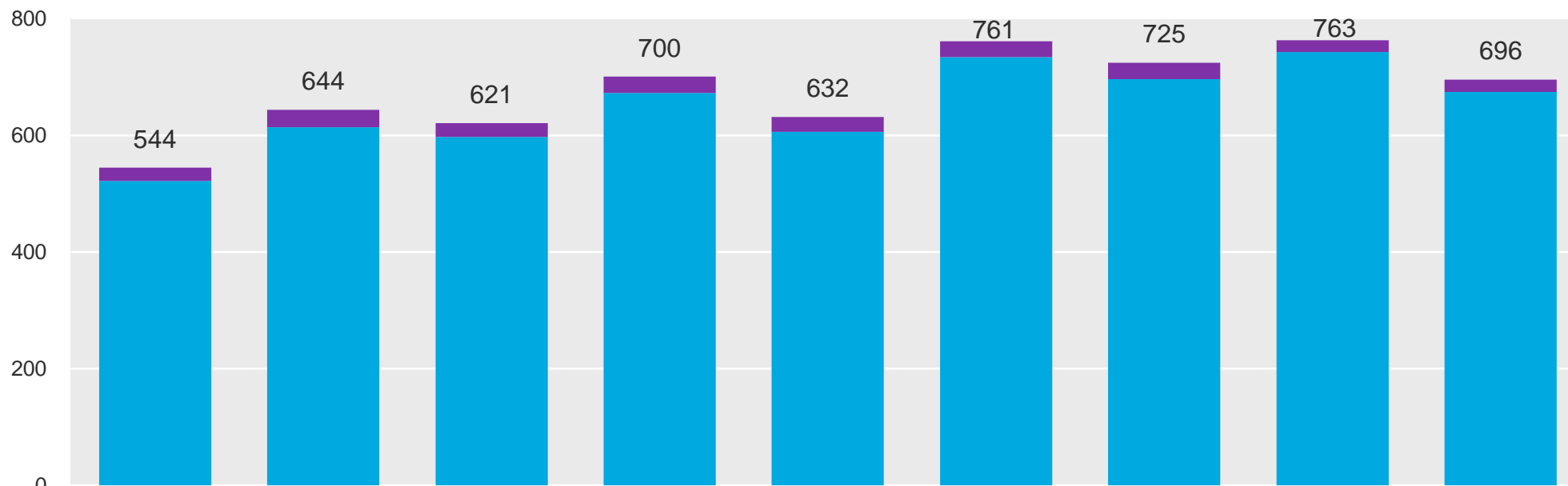
	Q1 FY'18	Q2	Q3	Q4	Q1 FY'19	Q2	Q3	Q4	Q1 FY'20
日本	267	384	351	451	511	580	540	427	325
北米	240	320	291	339	284	459	227	347	285
欧州	253	269	196	250	177	313	186	253	202
韓国	683	1,017	794	1,223	889	865	609	689	369
台湾	458	366	421	443	263	480	293	591	483
中国	267	230	226	318	549	713	380	425	270
東南アジア・他	46	67	132	234	127	168	156	152	44

SPE部門 新規装置 アプリケーション別売上構成比



フィールドソリューション売上高

(億円)

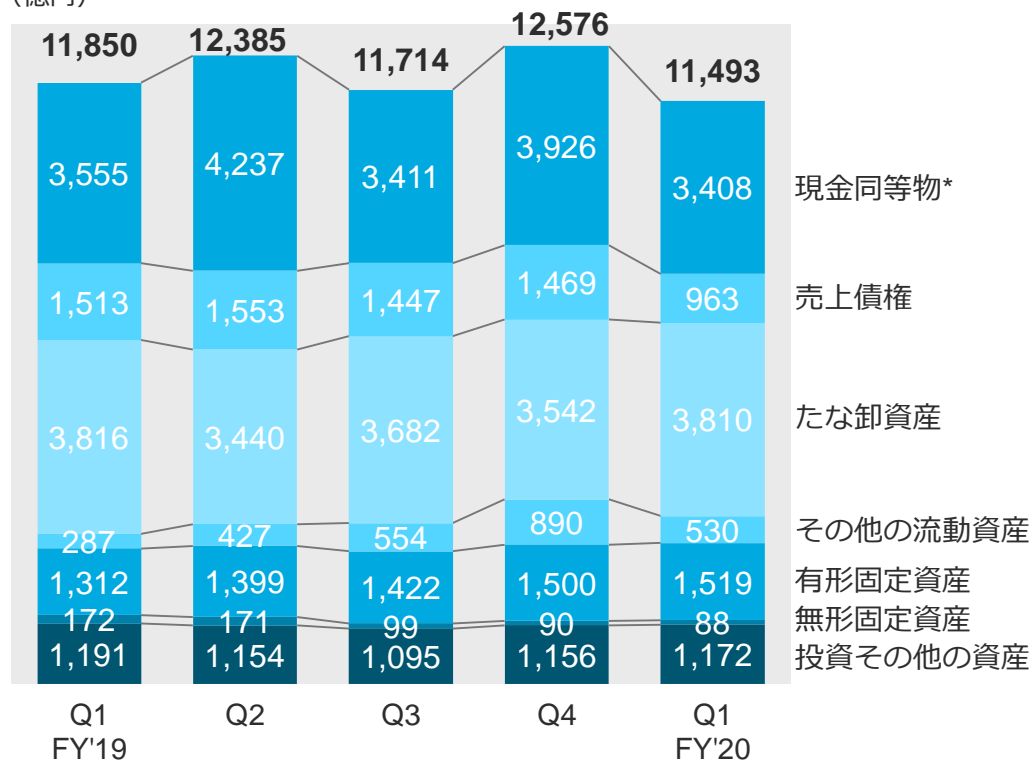


	Q1 FY'18	Q2	Q3	Q4	Q1 FY'19	Q2	Q3	Q4	Q1 FY'20
SPE売上高	522	614	597	672	606	734	696	742	674
FPD売上高	22	29	24	28	25	27	28	21	21

貸借対照表

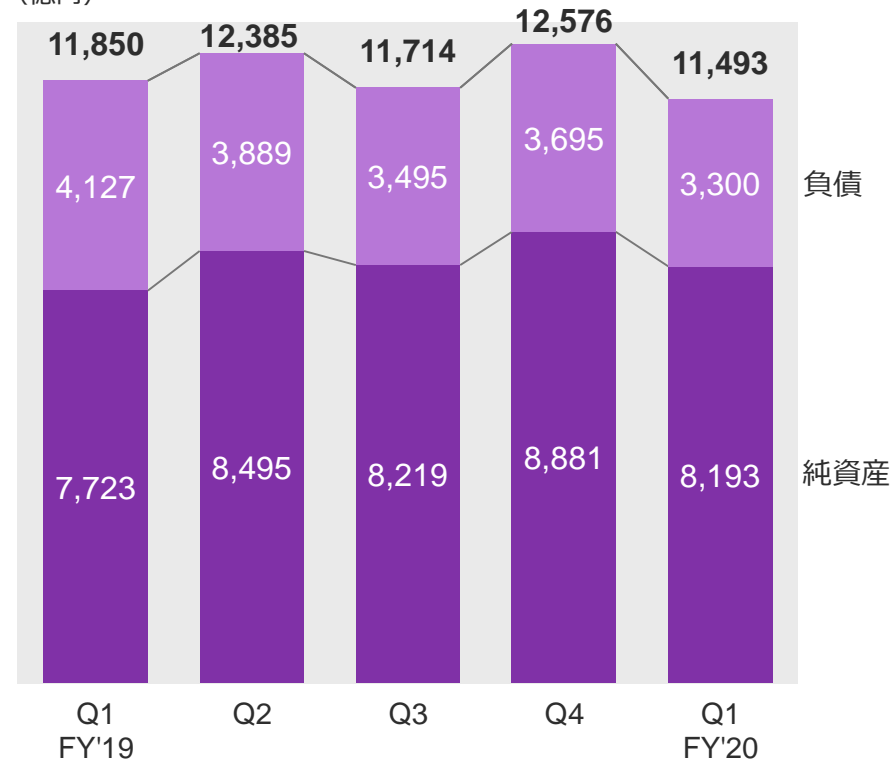
資産

(億円)

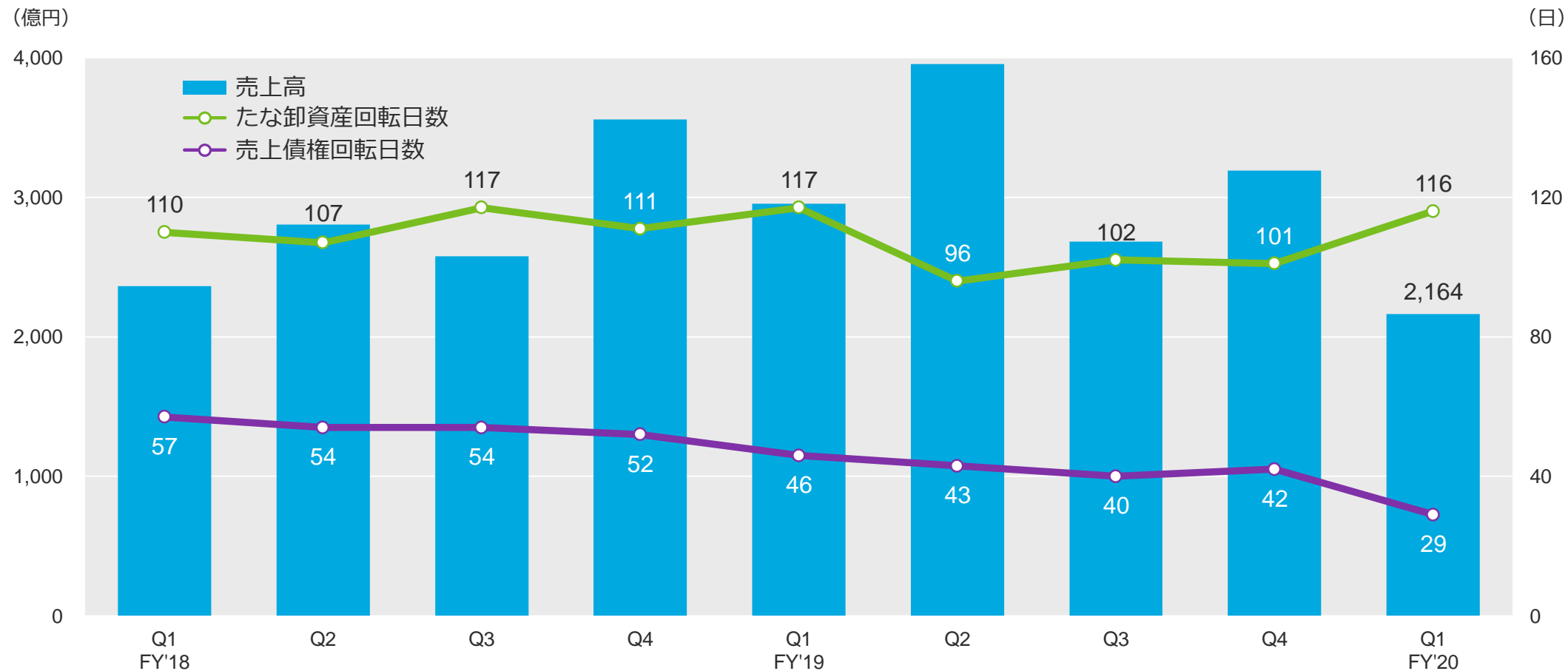


負債・純資産

(億円)



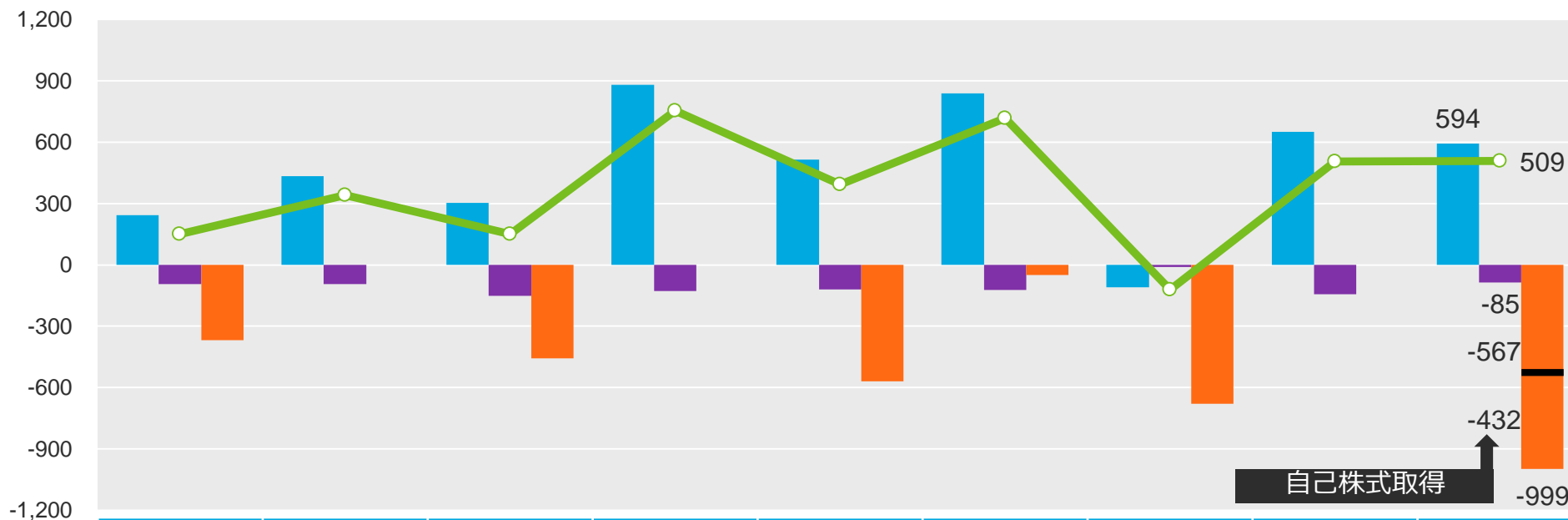
たな卸資産・売上債権の回転日数



回転日数 = 売上債権もしくはたな卸資産 ÷ 各四半期末までの12ヶ月間売上高 × 365

キャッシュ・フロー

(億円)



	Q1 FY'18	Q2	Q3	Q4	Q1 FY'19	Q2	Q3	Q4	Q1 FY'20
■ 営業キャッシュ・フロー	244	434	304	881	514	840	-110	650	594
■ 投資キャッシュ・フロー*1	-93	-94	-152	-128	-121	-122	-11	-144	-85
■ 財務キャッシュ・フロー	-368	-0	-457	-0	-569	-50	-678	-0	-999
○ フリーキャッシュ・フロー*2	151	340	151	753	393	717	-121	505	509
手元資金残高*3	2,946	3,299	3,012	3,738	3,555	4,237	3,411	3,926	3,408

*1 投資キャッシュ・フローは、満期3ヶ月超の預金等の増減額を除いた金額です。

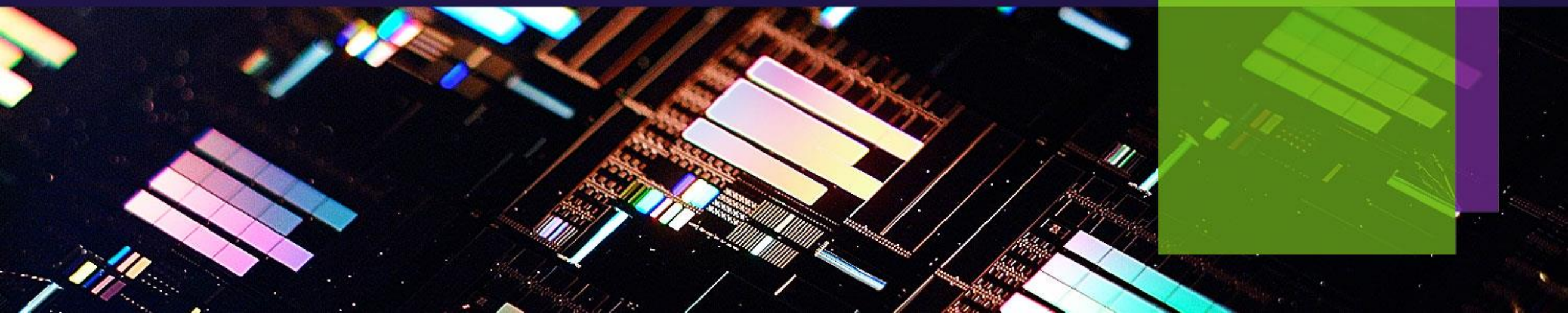
*2 フリーキャッシュ・フロー = 営業活動によるキャッシュ・フロー + 投資活動によるキャッシュ・フロー (満期3ヶ月超の預金等の増減額を除く)

*3 手元資金とは、現金及び現金同等物と満期3ヶ月超の預金等の合計金額です。

事業環境および業績予想

2019年7月26日

河合 利樹
代表取締役社長・CEO



事業環境（2019年7月時点での見方）

▶ 半導体前工程製造装置(WFE)*1の設備投資

CY2019の投資は、前年比15～20%程度の減少を想定。ロジック/ファウンドリ向けは堅調も、メモリは需給の軟化とマクロ経済の影響で一時的に投資調整。在庫調整が進み、メモリはCY2020に投資回復の見込み

▶ FPD製造装置 TFTアレイ工程*2向け設備投資

CY2019は、モバイル用途のOLEDパネル向け設備投資が軟調、大型パネル向けは一時的に投資調整。通年では前年比30%程度の減少も年後半から回復基調に転じると期待

*1 半導体前工程製造装置（WFE; Wafer fab equipment）：半導体製造工程には、ウェーハ状態で回路形成・検査をする前工程と、そのウェーハをチップごとに切断し、組み立て・検査をする後工程があります。半導体前工程製造装置は、この前工程で使用される製造装置です。また半導体前工程製造装置は、ウェーハレベルパッケージング用の装置を含んでいます。

*2 TFTアレイ工程：ディスプレイを駆動する電気回路機能を持つ基板を製造する工程

CY2019 アプリケーション別のWFE市場と事業機会

- ロジック/ファウンドリ：前年比35%程度増加
 - 市場環境：世代移行による設備投資増加。10nm以細の世代向けが5割を占める
 - 事業機会：難易度の高まるパターンニングでのビジネス拡大
- 不揮発性メモリ：前年比60%程度減少
 - 市場環境：歩留まり向上により生産能力の増強投資は調整中だが、在庫は減少方向へ。9X/12X層数の世代向けが全体投資の8割以上
 - 事業機会：高付加価値のエッチング・洗浄工程での差別化
- DRAM：前年比40%程度減少
 - 市場環境：設備投資の約6割が1Y/1Znm世代向け
 - 事業機会：最先端世代における一括パターンニング

CY2019のメモリ向け投資は抑制されるも、CY2020に回復する見込み

FY2020 事業進捗 (Q1)

■ SPEの事業戦略は計画通り進捗

- 注力分野で POR*1の獲得が進む
 - エッチング : 拡大するIoT・Automotive分野で受注増加
 - 成膜/洗浄 : メモリ向けクリティカル工程でPOR獲得
- 高付加価値のウェーハプロローバ Cellcia™ : 不揮発性メモリにおいて新規受注
- インストールベースの増加に伴い、フィールドソリューションは引き続き好調
- 今後大きく成長するAutomotiveやIndustry向けの半導体製造装置やプロセス技術の開発において、BRIDG*2と提携

■ FPD製造装置の新製品の販売が順調に進む

- 高精細FPD向け第10.5世代プラズマエッチング装置 Impressio™ 3300 PICP*3™
- 有機ELディスプレイ向け第4.5世代インクジェット描画装置 Elius™ 1000

*1 POR (Process of record) : 顧客の半導体製造プロセスにおける装置採用の認定

*2 BRIDG (Bridging the Innovation Development Gap) : 米国フロリダ州にある非営利のコンソーシアム

*3 PICP : パネル基板上に極めて均一な高密度プラズマを生成するプラズマソース

FY2020 業績予想

FY2020 業績予想 (2019/4/26発表から変更なし)

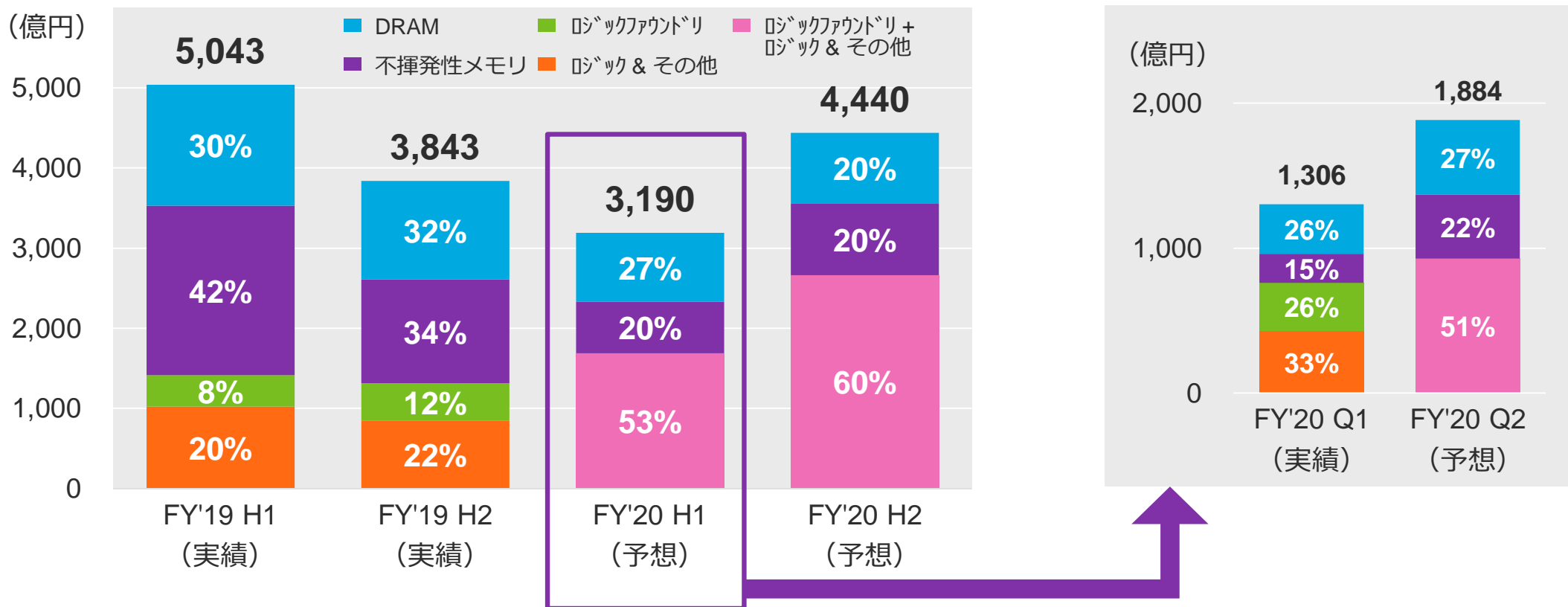
(億円)

	FY2019 (実績)	FY2020 (予想)			
		H1	H2	通期	通期 対前年増減
売上高	12,782	4,900	6,100	11,000	-13.9%
SPE	11,667	4,500	5,800	10,300	-11.7%
FPD	1,112	400	300	700	-37.1%
売上総利益	5,261	1,920	2,490	4,410	-851
下段：売上総利益率	41.2%	39.2%	40.8%	40.1%	-1.1pts
販管費	2,156	1,070	1,140	2,210	+53
営業利益	3,105	850	1,350	2,200	-905
下段：営業利益率	24.3%	17.3%	22.1%	20.0%	-4.3pts
税金等調整前当期純利益	3,215	850	1,350	2,200	-1,015
親会社株主に帰属する 当期純利益	2,482	630	1,010	1,640	-842
1株当たり当期純利益 (円)	1,513.58	388.83	-	1,015.21	-498.37

市場は調整局面も、来年の市場回復に向けて成長投資を継続

FY2020 SPE部門 新規装置売上予想

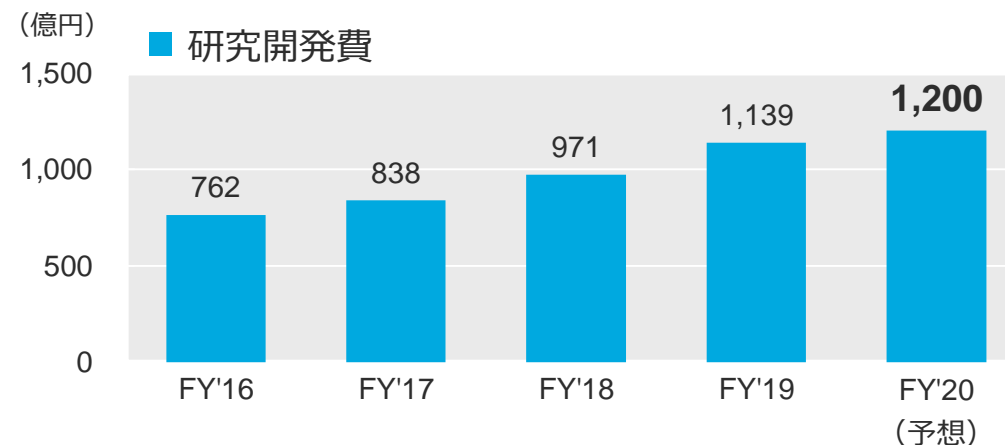
アプリケーション別売上構成比



Q1実績は計画通り、Q2売上計画の大半が出荷済み
ロジック・ファウンドリ向け売上が大きく伸長

FY2020 研究開発費・設備投資計画

- 開発費 1,200億円
 - 注力分野および持続的成長を見据えた投資継続
- 設備投資 560億円
 - 先端技術開発・増産対応への積極的な投資
- 減価償却費 330億円



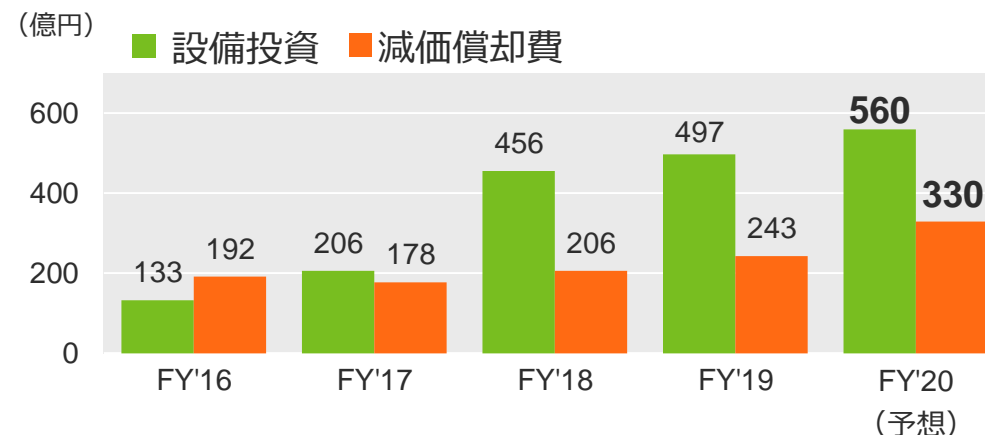
新生産棟の建設
(成膜装置・ガスケミカルエッチング装置・テストシステム)



山梨県富士市：建設費約130億円
(2019年2月着工、2020年4月竣工予定)

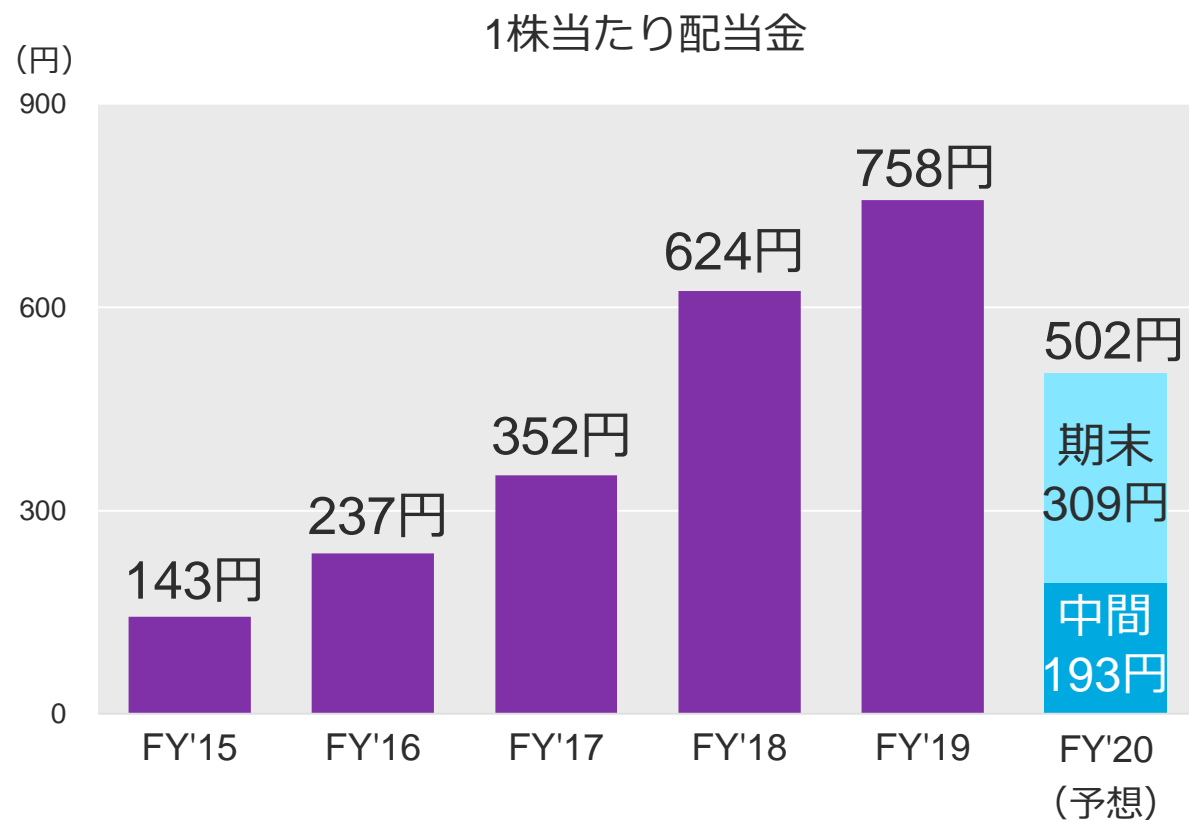


岩手県奥州市：建設費約130億円
(2018年10月着工、2019年10月竣工予定)



中期計画達成とさらなる成長を視野に先行投資を継続

FY2020 配当予想 (2019/4/26の業績予想発表時点)



当社の株主還元策

連結配当性向： 50%

但し、1株当たり年間配当金150円を下回らない

2期連続して当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討する

自己株式の取得： 機動的に実施を検討

進行中の自己株式取得による配当金の修正は
第2四半期決算時に発表予定

TEL™

TOKYO ELECTRON